

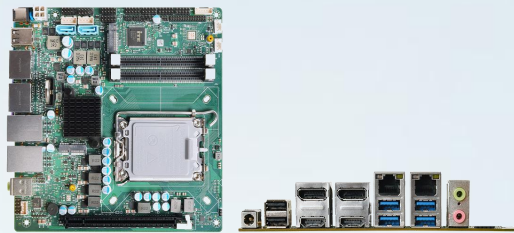


## ITX610B (R111)

### 产品特点

- ◆ Intel Core 12 代/13 代-S /14 代系列处理器, LGA1700 TDP 65W; H610/Q670
- ◆ 2\*DDR5 S0-DIMM, 最大 64GB
- ◆ 2\*Intel 网络 i219-LM + i226-V/i219\_V+i226V, 2\*HDMI, 2\*DP, eDP/LVDS
- ◆ M-Key 2280, E-Key, PCIe\_x16
- ◆ 电源: DC 12-24V & 12V, 120W 以上 (两种电源规格可选) 尺寸:170x170

mm



### 产品规格

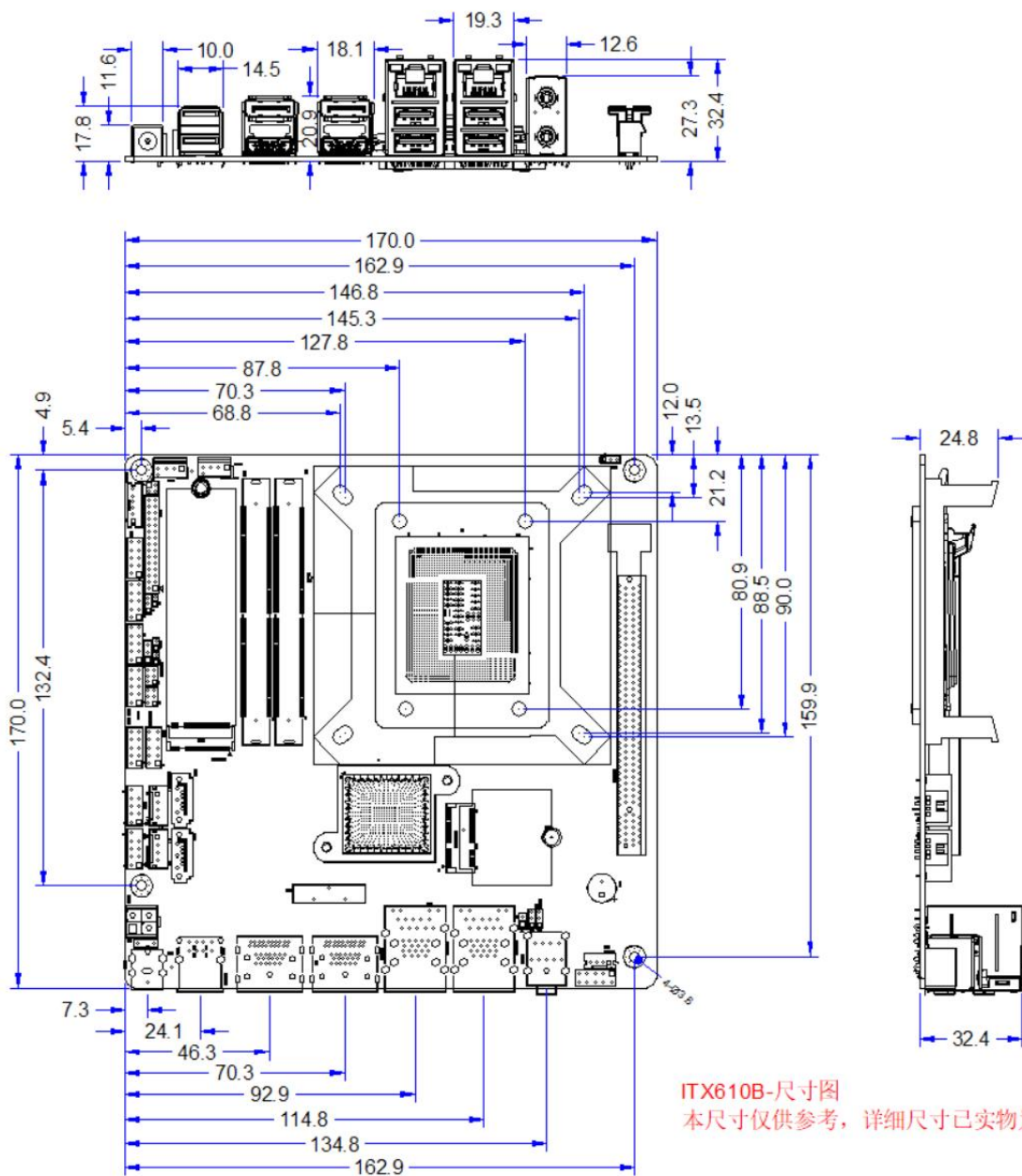
处理器系统	Intel Core 12 代/13 代-S / 14 代 系列, LGA1700, H610/Q670, TDP 65W
	EFI BIOS
内存	2*DDR5 S0-DIMM, 共最大 64GB
存储	1*M.2 M-Key 2280 (NVMe PCIe3.0_4X 默认/可选 SATA3.0 协议) 存储接口
	2*SATA3.0 接口
显示	2*HDMI2.1 接口, 支持 4096x2160@60Hz; 2*DP1.4, 支持 7680x4320@60Hz;
	配 H610 时, 只支持 3 显, 可任意 3 个同步和异步显示。配 Q670 时, 可任意同步或异步四显。
	eDP/LVDS
板边 I/O 接口	DC JACK, 2*USB2.0
	2*HDMI + DP
	2*(LAN + 2*USB3.2), 2 孔音频输入输出 (Line out, Mic in)
扩展接口/功能	TPM2.0 可选, 默认没有
	1*PCIe_x16 (PCIe4.0_16X 协议)
	1*M.2 E-Key (PCIe3.0/USB2.0 协议, 支持 WIFI/BT 模块)
	4*COM 排针, 2x5Pin, 间距 2.54mm; COM1/2 可选 RS232/485, COM3/4 为 RS232
	2 组 4 个 USB2.0 排针, 间距 2.54mm (其中 1 个 USB2.0 与 BT 共 LAY 的)
	8*GPIO 排针, 2x5Pin, 间距 2.54mm
	1*4Pin PWM CPU 风扇, 1*4Pin 系统风扇
电源	DC 12-24V & 12V, 120W 以上 (两种电源规格可选)
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	170x170 mm
重量	约 400g



# ITX610B(R111)

## 产品尺寸

单位: mm



## 订购信息

型号	可选项目	可选项描述
ITX610B	外置 TPM2.0	外置 TPM2.0 可选
	串口 COM1/2 可选 232/485	RS232/RS485 可选
	其中 1 组 USB2.0 插针	其中 1 组 USB2.0 插针与 BT 可选
	芯片组	H610 / Q670
	M.2 M-Key	PCIe3.0 4X/SATA3.0 协议可选